

证券代码：000021

证券简称：深科技

深圳长城开发科技股份有限公司
2025 年 10 月 15 日投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系 活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	广发基金、泰康资产、博时基金、华泰证券、平安证券、汇添富基金、大成基金、兴业证券、宝盈基金、鹏华基金、国泰基金、宏利基金、长江证券
时间	2025 年 10 月 15 日
地点	公司本部会议室
上市公司 接待人员姓名	董事、副总裁周庚申 董事会秘书钟彦
投资者关系活 动主要内容介 绍	本次会议主要介绍了公司概况、发展历程、全球布局、核心竞争优势以及产品与业务，并就调研投资者关心的公司所处行业动态、三大主营业务情况、未来发展方向等有关问题进行了解答。 一、公司基本情况介绍 公司是全球领先的专业电子制造企业，连续多年在 MMI（Manufacturing Market Insider）全球电子制造服务行业（Electronic Manufacturing Service, EMS）排名前列。公司专注于为客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流、销售等一站式电子产品制造服务。以先进制造为基础，以市场和技术为导向，公司坚持高质量发展，构建了以存储半导体、高端制造、计量智能终端为三大主营业务的发展战略。

	二、交流环节 1. 公司硬盘盘基片方面的情况如何？ 答：公司硬盘盘基片累计出货量已突破25亿片，主要得益于技术研发的坚持与突破。公司通过组建专业研发团队，引入仿真分析等先进研发方法，实现了产品技术向“薄型化、高容量”升级，硬盘容量从早期不足1TB提升至36TB，应用领域扩展至大数据服务器、云计算中心等高端应用场景。目前正推进AI技术与全流程自动化的深度融合，通过工艺优化、质量预测、设备维护等环节强化AI分析能力，结合自动化模块实现全链路自动化流转，提升生产效率与产品一致性，为应对未来数据存储市场的变化提供可靠的制造能力保障。 2. 公司半导体先进封装和测试的技术如何？ 答：作为国内高端存储芯片封测的龙头企业，公司拥有行业经验丰富的研发和工程团队，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软件开发能力。同时，公司密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势。 3. 市场上存储产品涨价对公司有什么影响？ 答：公司在封测环节收取的是加工费，加工费波动相比终端产品价格波动相对有限。 4. 公司存储半导体封测业务产能情况如何？ 答：公司目前存储半导体封测业务产能有序推进，产能利用可以满足订单需求，公司将持续关注市场机遇，如未来客户需求增长，公司将以满足主要客户需求来推进扩产计划。 接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 10 月 15 日